

K-반도체기업 '새판'

# 삼성 "HBM 판매비중 확대"... TSMC 등 글로벌 협력 예고

## 3분기 실적 컨퍼런스콜

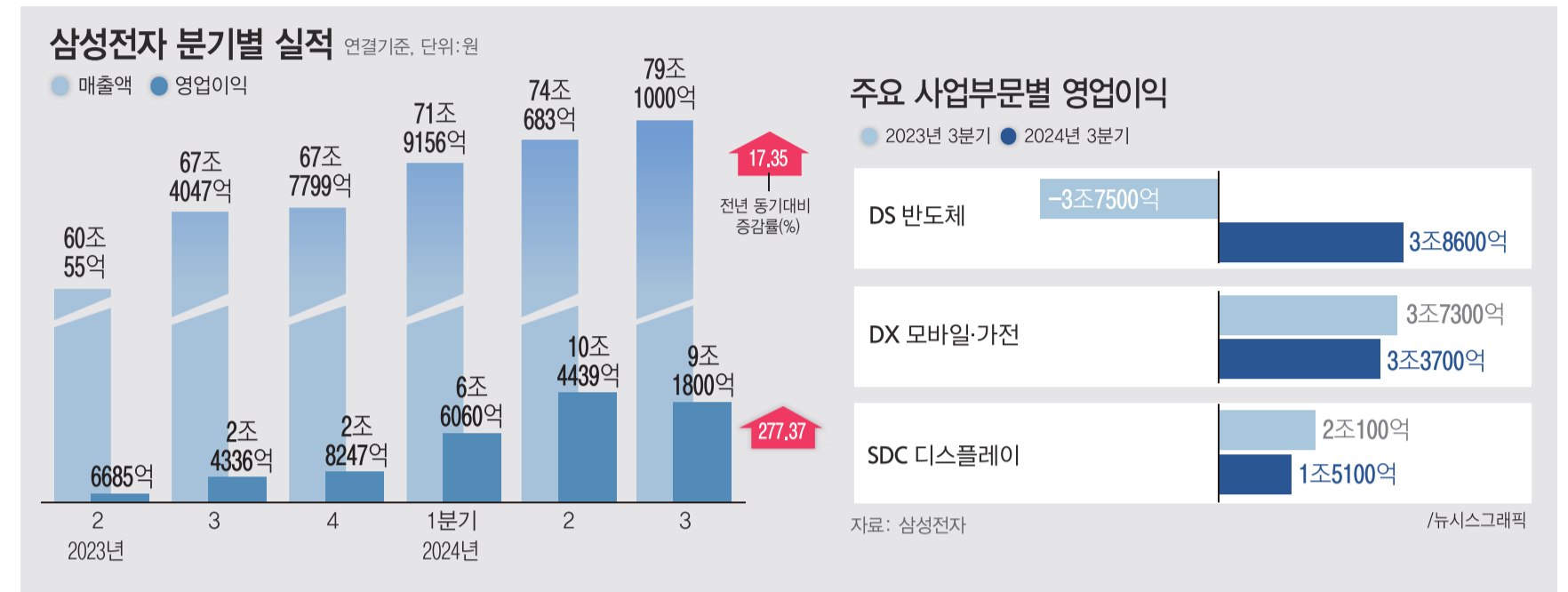
분기실적, 시장 기대치 밀돌아  
내년 'HBM4' 통해 반전 모색  
빅스비 등 AI 기능 고도화

올해 3분기 실적 기대치를 밀도는 실적을 공개한 삼성전자가 컨퍼런스콜(설명회)을 통해 위기를 돌파하기 위한 전략을 공개했다. 인공지능(AI) 기능을 고도화하고 향후 고대역폭메모리(HBM) 판매 확대를 통해 수익성 확보에 주력한다는 게 핵심이다. 내년 첫선을 보일 '고대역폭메모리(HBM4)'를 반전 카드로 삼고 TSMC 등 경쟁사와의 협력도 고려하겠다는 방침이다. 특히 HBM3E의 엔비디아 납품 가능성도 시사했다.

삼성전자는 31일 주력인 반도체 사업에서 시장 전망치를 밀도는 3조8000억원의 실적을 기록했다고 밝혔다. 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 9조1800억원으로 지난해 동기보다 277.37% 증가했다. 다만 이는 이미 낮아진 시장 전망치를 14% 가량 밀도는 성적이다.

### ◆HBM3E 엔비디아 납품 가능성 시사

김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 이날 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 "HBM 3분기 매출은 전분기 대비 70% 이상 성장했으며 HBM3E 8단과 12단 제품을 양산해 판매 중"이라고 밝혔다. 전체 HBM 사업 내 HBM3E 매출 비중은 3분기 10% 초중반 수준까지 증가했다. 김 부사장은 "일부 사업화 지연이 있어 전분기 발표 수준보다는 하회하겠지만 4분기 HBM3E 매출 비중은 50% 정



도로 예상된다"고 말했다. 그러면서 HBM 비중 확대로 수익성을 확보하는 동시에 엔비디아 납품 가능성도 시사했다.

그는 "예상 대비 주요 고객사향 HBM3E 사업화가 지연됐지만 현재 주요 고객사 퀄컴 테스트 과정상 중요한 단계를 완료하는 유의미한 진전을 확보했고, 이에 4분기 중 판매 확대가 가능할 것"이라며 HBM3E 제품의 엔비디아 납품 임박을 알렸다.

특히 HBM의 주요 경쟁력으로 볼 수 있는 6세대 HBM4 제품의 경우 경쟁사와의 협력 가능성도 열었다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC와 손잡고 '고대역폭메모리(HBM)' 생산을 확대하겠다는 방침이다.

삼성전자는 HBM 사업과 관련해 "복수 고객사들과 커스텀 HBM 사업화를 준비하고 있다"고 밝혔다. 이어

"HBM4 제품은 내년 하반기 양산을 목표로 개발 중이며 핵심인 '베이스다이'와 관련한 파운드리 파트너 선정은 고객 요구를 우선으로 유연 대응할 예정이라고" 말했다.

그러면서 삼성전자는 파운드리 투자 집행 규모는 감소할 것으로 봤다.

삼성전자는 "올해 파운드리 투자는 모바일, HPC 고객 수요 중심으로 이뤄졌다"며 "시황 및 투자 효율성을 고려해 기존 라인 전환에 우선순위를 두고 투자 운영 중이나 금년 캐패시 투자 집행 규모는 감소 전망"이라고 설명했다. 다만 "내년은 생산 인프라 가동 극대화 선단 레거시 노드 고객 주문에 적기 대응하고 최선단 R&D 캐파 투자는 가동 및 수익성을 고려해 효율적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.

### ◆DDR5 등 수익성 확보 주력

삼성전자는 DDR5, 서버용 SSD 등

고부가 비중을 확대해 반도체를 중심으로 수익성 확보에 주력한다는 방침이다.

삼성전자는 "인공지능(AI) 스마트폰이 빠르게 진화하면서 하드웨어 사양과 더불어 AI 기능도 더 발전할 것으로 예상된다"며 "자사는 최고의 AI 기능을 고객에게 제공하는 것을 목표로 이를 충족하는 애플리케이션 프로세서(AP), 메모리 등의 채용을 검토 중"이라고 밝혔다.

아울러 음성 비서인 빅스비도 고도화하겠다는 계획이다. 삼성전자는 "생성형 AI 모델을 온디바이스로 실행하기 위해선 고성능 AP 및 메모리가 필요하므로 이를 해결하기 위한 다양한 기술 및 솔루션도 함께 검토 중"이라며 "또 삼성전자는 업그레이드된 AI 음성 비서인 빅스비를 TV 및 가전제품에 적용해 올해 8월 말 글로벌 출시했다. 향후에는 보다 복잡한 기능 수

행까지 가능한 스마트폰 버전도 출시할 예정"이라고 전했다.

다만 내년 스마트폰 시장이 1% 미만 성장할 것으로 내다봤다.

삼성전자는 "올해 전 세계 스마트폰 시장이 2.5% 성장할 것으로 전망되는 것에 비해 내년에는 1% 미만 성장하는 데 그칠 것"이라고 말했다. 이어 "온디바이스 AI 모멘텀은 견조할 것으로 예상되고, 중국 경기 부양책이 스마트폰 시장의 성장 기회가 될 수 있다"고 했다.

한편 갤럭시 폰의 슬립화는 지속하겠다는 방침이다. 삼성전자 관계자는 "갤럭시 플립은 차별화된 디자인, 커버 스크린으로 프리미엄 가치 제고하겠다"며 "더 강력한 모바일 경험 원하는 소비자들의 신규 폼팩터 준비 중이다"라고 전했다

/구남영 기자 koongja\_tea@metroseoul.co.kr

## 자체 AI 칩 개발 속도... 脫엔비디아 나선다

### 비용 부담, 공급 지연 등 리스크 완화 "시장 반향 얻지 못하면 계류 될 수도"

인공지능(AI) 반도체 기업들의 탈(脫)엔비디아를 위한 자체 AI 칩 개발이 계속되고 있다.

현재 엔비디아의 AI 칩은 관련 시장 점유율 90% 수준을 차지하고 있다. 주요 빅테크 기업들의 엔비

디아 AI 칩 확보를 위한 경쟁이 치열해지며 가격은 치솟았고 공급 속도 지연 등이 기업의 리스크로 떠올랐다. 이에 비용 부담을 덜며 엔비디아 의존도를 낮추고, 자사 맞춤형 AI 칩 개발이 활발하게 이뤄지고 있다.

31일 관련업계에 따르면 국내 양대 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉

스가 엔비디아 의존도 재고를 위한 차세대 AI 칩 개발에 착수했다.

먼저 삼성전자는 AI 향(向) 포트폴리오 재편을 예고 했다.

삼성전자는 "메모리는 서버 수요 강세가 유지되고 모바일은 일부 고객사 재고 조정이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 수익성 위주로 사업 포트폴리오를 개선할 방침"이라며

고용량 및 고성능 제품 수요 증가에 대응한 첨단공정 비중을 확대하기로 했다.

SK하이닉스는 현재 주도권을 확보한 고대역폭메모리(HBM) 신장 개발에 집중하는 한편, '메모리 센트릭'을 비전으로 삼고 다양한 AI 메모리 개발에 박차를 가하고 있다.

특히 올해는 PIM, CXL, AI 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등으로 라인업을 강화하고 있다. 다변화한 AI 서비스에 발맞춰 각 고객에 최적화된 맞춤형 AI 메모리

개발에 집중하면서 혁신 소자 기반의 차세대 이머징 메모리도 개발 중이다.

업계 관계자는 "당장 1,2년 내로 대대적인 변화가 나타날지는 알 수 없으나 거대한 자금력을 바탕으로 한 기업들이 개발에 뛰어들어 상생"이라며 "그러나 인텔이 차세대 AI 가속기 가우디3를 공개하고도 별다른 시장 반향을 얻지 못한 것을 고려한다면 계류가 될 수도 있을 것"이라고 말했다.

/김서현 기자 seoh@

## 한은 "현금결제 수용성 높이는 정책 필요"

### 디지털 이해도와 현금수요 보고서 "비대면 결제에도 현금 이용 성향 여전"

디지털 금융을 이용하기 어려운 소비자는 코로나19와 같이 비대면 결제방식이 강제되는 상황에서도 현금을 계속 이용하려는 성향이 강한 것으로 나타났다. 현금을 받지 않는 상점·서비스 증가에 따른 불편함도 디지털 소외계층에 집중될 수 있다는 분석이 나온다.

한국은행은 31일 '코로나19 팬데믹 기간중 디지털 이해도와 현금수요 간의 관계(Digital Literacy and Physical Cash Demand during the COVID-19 Pandemic)' 보고서를 통해 이같이 말했다.

이번 보고서는 2021년 한은 지급수단 및 모바일금융서비스 이용 행태조사에 이용된 마이크로데이터, 지역별 거리두기 단계자료, 지역별 금융기관 점포 및 ATM 분포자료를 결합해 회귀

분석했다.

분석결과 디지털 이해도가 낮은 소비자는 코로나19와 같이 비대면 결제방식이 강제되는 상황에서 현금을 계속 이용하려는 성향이 강했다

팬데믹 기간, 디지털 이해도가 낮은 소비자가 휴대하는 현금을 줄일 확률은 16%에 불과했다. 디지털 이해도가 높은 소비자가 휴대 현금을 줄일 확률이 26%인 것과 비교하면 10%포인트(p) 낮은 수준이다.

모바일 금융서비스를 이용할 가능성도 낮았다. 디지털 이해도가 낮은 소비

자가 모바일금융서비스를 이용할 확률은 32%로 디지털 이해도가 높은 소비자(46%)에 비해 12%p 낮았다.

특히 사회적거리두기 4단계가 시행된 지역의 경우 모바일금융서비스 이용을 늘릴 확률은 디지털 이해도가 낮은 소비자가 37%, 이해도가 높은 소비자는 51%로 나타났다. 디지털 이해도가 낮은 소비자는 비대면 결제방식이 확대되면 확대될수록 모바일금융서비스를 이용하려는 비중이 더 낮아질 수 있다는 분석이다.

이에 따라 한국은행은 현금 결제를

받지 않는 상점·서비스의 등장으로 피해를 볼 수 있는 소비자는 디지털 이해도가 낮은 소비자가 될 것이라고 분석했다. 특히 여타 연령층에 비해 현금 의존도가 높고 디지털 이해도가 낮은 고령층 소비자의 금융이용이 줄어들 수 있다는 설명이다.

한은 관계자는 "단기적으로는 현금결제 수용성을 높이는 정책방향을 마련해야 한다"며 "중장기적으로는 새로운 지급결제수단 도입시 디지털 소외계층도 손쉽게 활용할 수 있도록 정책적 고려가 필요하다"고 말했다. /나유리 기자 yul115@